

## 株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日

配当金受領 期末配当金:3月31日

株主確定日 中間配当金:9月30日

単元株式数 100株

定時株主総会 毎年6月

公告方法 電子公告(<https://www.fujimiinc.co.jp>)  
ただし、事故その他やむを得ない事情によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することといたします。

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 〒100-8212  
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

郵便物送付先 及び照会先 〒137-8081  
新東京郵便局私書箱第29号  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
電話 0120-232-711 (通話無料)

## 株式会社フジミンコーポレーテッド

お問い合わせ先：経営企画部経営企画課  
TEL：052-503-8181 (代表)  
URL： <https://www.fujimiinc.co.jp>

Copyright (C) 2024 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

## 各種手続のお申出先

- 支払期間経過後の配当金のお支払いについては、株主名簿管理人にお申出ください。
- 住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等

証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券会社へお申出ください。

証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社へお申出ください。

ご注意 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、日本証券代行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理人に、お問い合わせください。

特別口座管理機関 日本証券代行株式会社

連絡先 〒168-8620  
東京都杉並区和泉二丁目8番4号  
日本証券代行株式会社 代理人部  
電話 0120-707-843 (通話無料)

株式会社フジミンコーポレーテッド 株主通信

# FUJIMI TODAY vol.58

2023.4.1 ~ 2024.3.31

2024年6月発行

## 特集

## 株主様アンケート結果のご報告と ご質問への回答

技術を磨き、心をつなぐ

# FUJIMI

証券コード 5384



お客様目線の実践

パウダー&サーフェスカンパニーへの進化

「働きがい」と「働きやすさ」の醸成

当事者意識とやり抜く力の確立

革新への挑戦



この印刷物は、適切に管理された森林で生産された木材を使った環境配慮型のFSC®認証紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しております。

# 技術を磨き、心をつなぐ

私たちの「磨く技術」は半導体をはじめとしたさまざまな産業で活かされています。フジミはお客様にあらゆる製品を磨いていただくことで、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

代表取締役社長

関 敬史



## 株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

### 2024年3月期の経営成績

当社グループを取り巻く環境は、世界的な景気後退と地政学リスクへの懸念が一層高まり、世界経済の不透明感は強まりました。インフレ率は鈍化傾向を見せながらも高水準で推移する中で、中国経済は力強さを欠き、中東情勢は悪化の一途をたどっており、世界経済の下振れ懸念が続いております。

世界半導体市場は、AI向け半導体デバイスの需要が高まる一方、コロナ特需の反動によるパソコンやスマートフォン市場の低迷に伴う半導体デバイスの生産及び在庫の調整が継続するなど、各々の用途により方向感にバラつきが見られました。また、シリコンウェハーにおいても稼働調整が続いております。

こうした状況下、半導体向け製品の販売が減少したことに加え原材料価格などの上昇の影響を受け、当連結会計年度の業績は、売上高51,423百万円(前期比11.9%減)、営業利益8,251百万円(前期比37.7%減)、経常利益8,958百万円(前期比34.1%減)、親会社株主に帰属する当期純利益6,499百万円(前期比38.6%減)となりました。当期末配当金につきましては、期初からの変更はなく、1株36.67円とし、年間配当は1株73.34円としております。

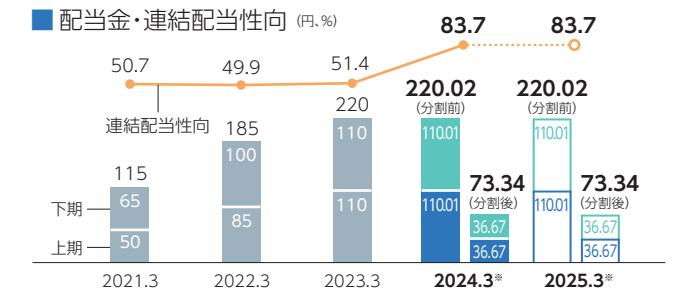
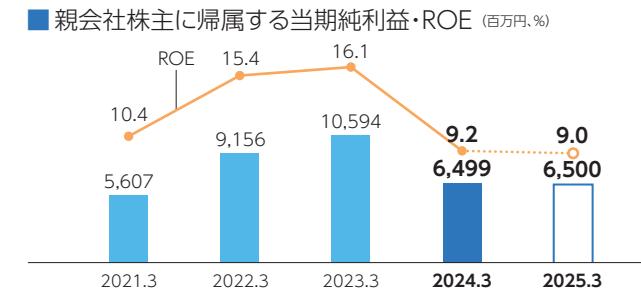
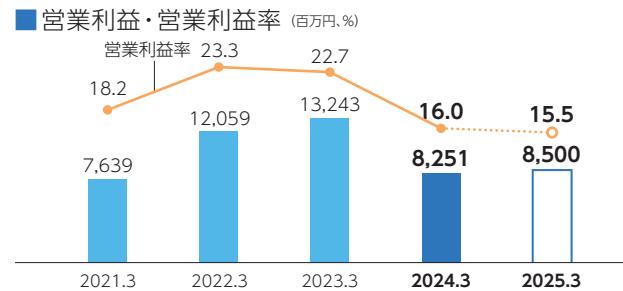
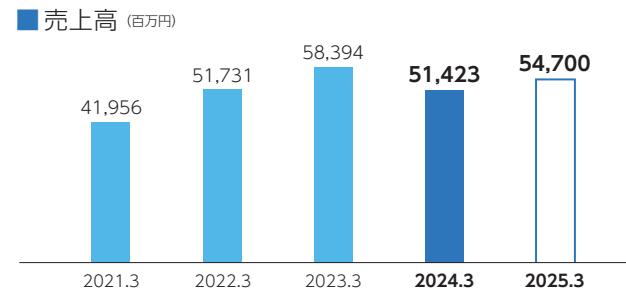
### 2025年3月期の見通しについて

2025年3月期の見通しにつきましては、世界経済の不透明感が引き続き強い中で、高価格のAI向け半導体により半導体出荷額は改善を示しているものの、スマートフォン、パソコン市場は低調に推移しており半導体生産量の本格的な回復には依然時間を要すると見込んでおります。次期は売上高54,700百万円(前期比6.4%増)、営業利益8,500百万円(前期比3.0%増)、経常利益8,700百万円(前期比2.9%減)、親会社株主に帰属する当期純利益6,500百万円(前期比0.0%増)を見込み、配当につきましては、1株につき中間配当金36.67円、期末配当金36.67円とし、年間配当金は当期の73.34円と同額を予定しております。

半導体市場は、短期的には本格的な回復に時間を要すると予測されますが、中長期的には旺盛な需要が見込まれます。当社においても将来のさらなる需要増加を見込み、研究開発や設備投資の手を緩めずに推進するとともに、誠実に、真摯にお客様の目線に立って、製品・サービスを提供してまいります。また、サステナブルな経営の根幹を成す人材投資やESGに関わる取り組みも積極的に推し進めてまいります。

皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

## 連結決算ハイライト ※2025年3月期は予想値



※当社は、2023年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合をもって株式分割を行っております。そのため、2024年3月期及び2025年3月期(予想)の配当金については、株式分割前の金額も記載しております。

# 株主様アンケート 結果のご報告と ご質問への回答



毎号、株主通信のアンケートには、多くの株主様からたくさんのお声を頂戴しております。ご回答いただきました株主の皆様におかれましては、お忙しい中ご協力いただきまして、誠にありがとうございます。

今号では、株主様にアンケート結果のご報告をするとともに株主様からのご質問にお答えいたします。

※過去の株主通信は当社ホームページ及び二次元コードよりご覧いただけます。  
<https://www.fujimiinc.co.jp/ir/library/report.html>



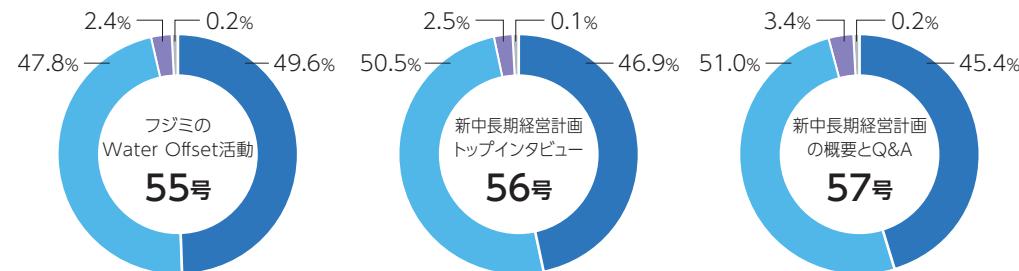
	55号	56号	57号
調査対象	5,719	5,809	6,494
回答数	2,159	2,284	2,617
回答率	37.8%	39.3%	40.3%

調査方法:ハガキによる調査

## アンケート結果

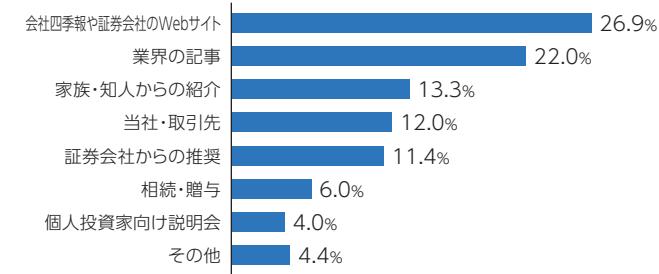
### 株主通信のご評価

■満足 ■やや満足 ■やや不満足 ■不満、回答なし



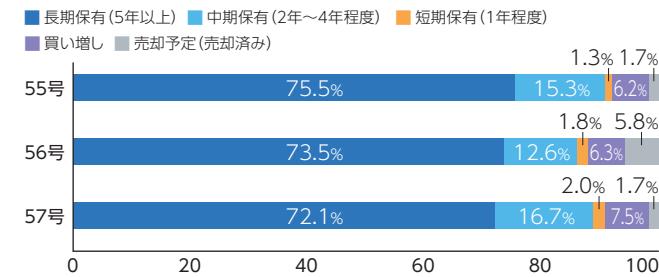
過去3号いずれも「満足」、「やや満足」の合計が9割以上とご評価いただきました。引き続き株主様にご満足いただける冊子づくりに努めてまいります。

### 当社を知るきっかけとなったものは何ですか? (57号より)



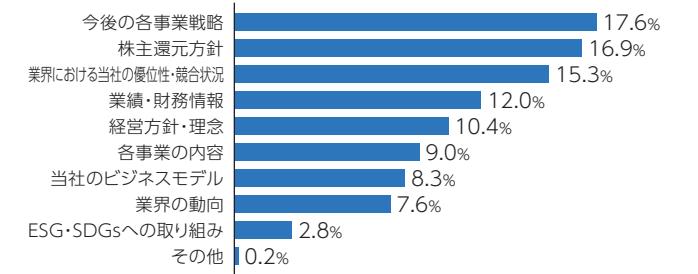
「会社四季報や証券会社のWebサイト」、「業界の記事」がともに2割以上を占めております。証券会社やマスメディアに取り上げていただく機会を増やしてまいります。

### 当社株式の今後の保有方針



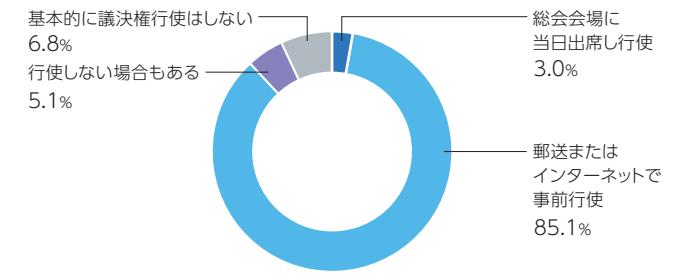
長期保有を方針とする人の割合は減少傾向であるものの、依然として大半を占めております。

### 当社について、もっと知りたい情報は何か?



「今後の各事業戦略」、「株主還元方針」、「業界における当社の優位性・競合状況」について高い関心をいただいております。

### 議決権行使に関する基本的な考え方



「総会会場に当日出席し行使」「郵送またはインターネットで事前行使」が合計約9割を占めております。

### INFORMATION



当社は、株主様のご意見・ご意思を伺う機会として株主総会における議決権行使と株主様のアンケート回答を大切にしております。株主総会における議決権は、株主様にとって当社の経営にご参加いただき、議案への賛成・反対の意思表示ができる権利であると同時に、当社にとっては、株主様のご意見・ご意思を伺うことができる大切な機会となります。議決権を行使していただいた株主様には御礼としてQUOカードをお送りしております。また、株主様との双方向のコミュニケーションを取ることを目的

※1単元(100株)以上の株主様を対象に実施しております。

に、株主通信(年に2回)と同梱してアンケートハガキ\*をお送りしております。受付期間内にアンケートにご回答いただけますと、御礼にノベルティをお送りしております。



(画像はイメージです。)

# ご質問への回答 もっと知りたい情報第1位

## 今後の各事業戦略 半導体向け超精密研磨材分野

当社売上高のうち8割強を半導体関連の売上が占めています。安定した事業バランスの構築を目指し、非半導体向けの新規用途開拓や研究開発に取り組んでおりますが、当社事業において引き続き中核をなすのは半導体向け製品(シリコンウェハー・CMP)となります。

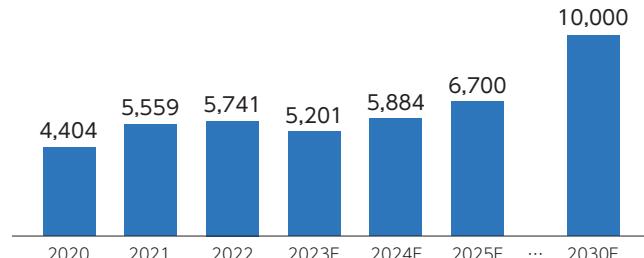
今号では、半導体向け超精密研磨材分野の事業戦略についてご紹介します。

## 市場展望について

半導体市場は、コロナ禍の巣ごもり特需の反動で、2022年秋頃よりパソコンやスマートフォン、サーバーなどの需要低迷を受け、2023年はマイナス成長となり、当社においても2024年3月期は前期比減収減益となりました。

一方で、半導体市場は2023年第2四半期(4月~6月)以降、単価の高い生成AI向けの需要の増加が市場を牽引することで

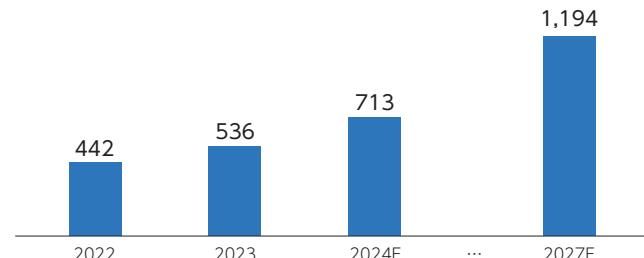
●世界半導体市場動向(年次 実績/予測) (億USDドル)



2020~2024F:世界半導体市場統計(WSTS)(2023年11月発表)を基に当社でグラフ作成  
2025F、2030F:各種資料を参考に当社でグラフを作成

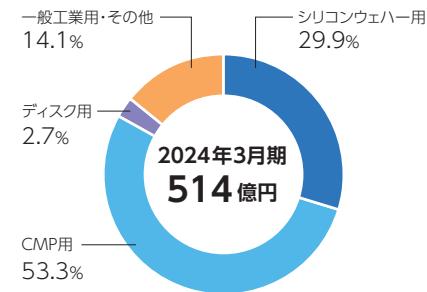
緩やかな回復基調を示しています。2024年後半にはパソコンやスマートフォンなどの需要も上向くと予測もあり、2024年、2025年はいずれも前年比で2ケタ台の成長が予測されています。その後、成長率はやや鈍化するものの、生成AI関連技術や車載用途での需要が成長を支え、2030年には市場規模が1兆ドルに達すると見込まれています。

●AI向け半導体の世界市場予測(年次 実績/予測) (億USDドル)



出所:米Gartner社  
AI向け半導体の定義:AIの学習・推論などに必要な「GPU、AIに最適化された半導体デバイス、またはFPGA」

●売上高構成比(用途別)



## 各事業の取り組み

当社の半導体向け超精密研磨材分野を担っているのは、シリコン事業とCMP事業になります。

シリコン事業では、パソコンやスマートフォンなどに使用される半導体の基板として用いられているシリコンウェハー向け研磨材を研究開発し、製造販売を行っております。半導体シリコンウェハーの製造プロセスにおける切断工程、ラッピング工程、複数のポリシング工程で当社製品は使用されており、その中でラッピング材、ファイナルポリシング材はいずれも世界シェアの8割から9割を占めています。

切断から仕上げ研磨までトータルで対応する製品ラインナップとサービスを強みに、高度化するお客様の要求にお応えするため、新技術に支えられた独自性の高い新製品の研究開発と製品供給を引き続き推進していきます。

CMP事業では、半導体デバイスの製造工程で用いられる研磨材を研究開発し、製造販売しています。CMP(化学的機械研磨)用

製品群は、トランジスタ素子形成工程(FEOL)や多層配線工程(BEOL)に対応した製品を揃えています。CMPスラリー全体での世界シェアは10%台と3位グループに位置していますが、半導体の性能を左右する最も微細な加工が要求されるFEOLで使用されるポリシリコン用ポリシング材に限れば世界シェアは約5割を占めています。

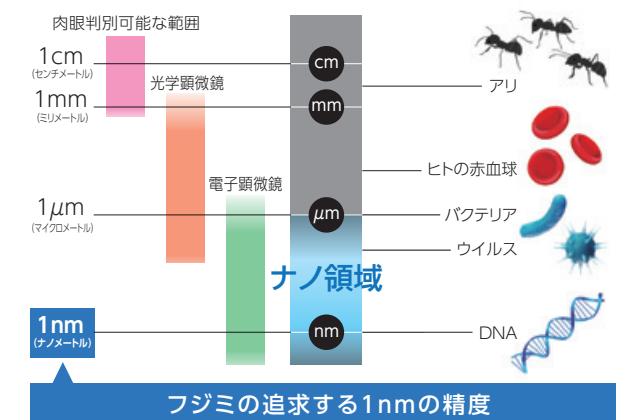
半導体デバイスの高性能化、高密度化、高集積化に伴い、研磨対象となる膜種(素材)とCMPが適用される工程は増加傾向にあります。加えて、近年はシステムとしての性能向上のために半導体デバイスを3次元に積層する技術が開発されており、その分野でもCMPの適用が検討されつつあります。お客様の製造・開発拠点に近い日本、台湾、米国に製造・開発拠点を設け、お客様とより密接な関係を構築し、お客様のロードマップに沿った新製品を開発しています。

## 研磨技術をリードするフジミの研磨材

半導体デバイスの製造にはナノレベルという高い研磨技術が必要です。フジミの追求する1nm(ナノメートル)の精度とは、インフルエンザウイルスの100分の1のレベル



です。半導体ウェハーを東京一名古屋間の300kmの平面に例えた場合、その平面上でわずか1cmの段差も許されません。



フジミの追求する1nmの精度

設備投資計画

※下記投資規模や稼働時期等の表は、各社プレスリリースや新聞等ニュース記事を基に作成

当社のお客様であるシリコンウェハーメーカー及び半導体メーカーの多くは、将来予想される旺盛な半導体需要に応えるべく積極的に大規模な設備投資計画を公表・実施しています。また、半導体の技術革新の進展に伴い、次世代製品開発や品質保証に関するお客様からの要求水準も高まっているため、当社

では将来のさらなる研磨材の需要増加と次世代製品の研究開発を見据え、国内外で段階的に設備投資と生産体制の整備を進めています。

日本、台湾、米国における設備投資の状況についてご紹介します。

日本

半導体の安定供給やカーボンニュートラルに向けた半導体のイノベーションなどを目的に政府が半導体産業を強力に後押ししており、半導体メーカー及びシリコンウェハーメーカーは多額の投資を進めています。当社においては、最先端製品の開発・生産・物流施設が集積する岐阜県各務原市で、2024年中に新工場の建設を開始します。新工場は、再生エネルギーを活用するなど環境に配慮するとともに、物流自動化などの最新設備を導入した工場となります。

TSMC社の日本進出 2024年5月現在

企業名	投資規模	場所	量産時期または稼働時期
JASM*	3兆円以上	熊本県	第1工場…2024年に量産出荷予定 第2工場…2027年に稼働開始予定

※JASM:Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社。TSMCにとって日本初となる工場で、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社と株式会社デンソー、トヨタ自動車株式会社が少数株主として参画。

当社新工場の建設予定地(左)及びイメージ図(右)



台湾

世界シェアトップのファウンドリ\*企業では、最先端ロジックデバイスの研究開発や量産に向け、多額の投資を行っています。当社子会社のフジミ台湾では、製品の需要増加を見越し、建屋の増築を完了しています。お客様の要望・計画に応じて、生産ラインを拡充するなど取り組みを進めています。

TSMC社新工場の計画 2024年5月現在

場所	プロセス	建設数	量産時期
新竹	2nm	4棟	1棟目 2025年量産予定
高雄	2nm	3棟	1棟目 2026年量産予定

\*ファウンドリ:半導体メーカーやファブレス(工場を持たない会社)からの委託を受けて半導体チップの製造を行う企業・サービスのこと。

米国

半導体産業の復興に向けて動き出した米国においては、世界の大手半導体メーカー各社が大規模な投資を進めています。当社子会社の米国フジミコーポレーションでは、お客様の量産開始時期などを念頭に、新たな生産体制の構築を進めています。

大手半導体メーカー3社の新工場建設と投資規模 2024年5月現在

企業名	投資規模	場所	量産時期または稼働時期
Intel	400億ドル	アリゾナ州	Intel3…2024年量産予定
		オハイオ州	Intel14A…2026年以降に稼働予定
TSMC	650億ドル	アリゾナ州	4nm…第1工場2025年前半量産予定
			2.3nm…第2工場2028年生産開始予定
			2nm以降…第3工場2030年までに生産予定
Samsung	440億ドル	テキサス州	新工場…2024年後半稼働開始予定 他、先端パッケージング・研究開発拠点の建設



シリコンウェハー用

売上構成比 29.9%

半導体基板となるシリコンウェハーを高精度に平坦化・鏡面化する研磨工程で用いられる研磨材を研究開発し製造販売する事業です。

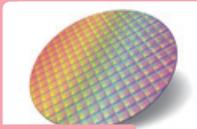
売上高 (百万円)

2023.3: 20,655

2024.3: 15,383

25.6% DOWN

顧客の稼働調整が継続したことを受け、売上高はラッピング材では5,474百万円(前期比22.4%減)、ポリシング材では9,909百万円(前期比27.2%減)となりました。



CMP用

売上構成比 53.3%

半導体デバイスの製造工程で用いられる研磨材を研究開発し製造販売する事業です。

売上高 (百万円)

2023.3: 28,668

2024.3: 27,401

4.4% DOWN

上期のマチュアロジックデバイスやメモリでの稼働調整を受け、売上高は27,401百万円(前期比4.4%減)となりました。



ディスク用

売上構成比 2.7%

デジタルデータの記録媒体であるハードディスクドライブ用ディスク基板の製造工程で用いられる研磨材を研究開発し製造販売する事業です。

売上高 (百万円)

2023.3: 1,506

2024.3: 1,383

8.1% DOWN

下期に入り顧客での稼働の回復が見られたものの、上期のHDD(ハードディスクドライブ)市場の生産及び在庫の調整を受け、売上高は1,383百万円(前期比8.1%減)となりました。



一般工業用・その他

売上構成比 14.1%

多種多様な用途向けに研磨材や機能性材料を提供しております。また、半導体装置、航空機及び鉄鋼などさまざまな業界の溶射用途向けに溶射材を提供しております。

売上高 (百万円)

2023.3: 7,554

2024.3: 7,254

4.0% DOWN

一般工業用研磨材につきましては、売上高は4,479百万円(前期比2.8%減)、その他につきましては2,775百万円(前期比5.7%減)となりました。

## SKシロン社より ベストパートナーアワードを受賞



2023年10月に、大手半導体シリコンウェハーメーカーである韓国のSKシロン社よりベストパートナーアワードを受賞しました。今回で3度目の受賞となり、同社との緊密な連携のもと、当社の高い技術力により積極的に高品質化に取り組み、製品を確実に供給したことを評価されました。

## SUMCO社より サプライヤーアワードを受賞



2024年1月に、大手半導体シリコンウェハーメーカーであるSUMCO社より2023年度サプライヤーアワードを受賞しました。今回で4度目の受賞となり、同社との緊密な連携のもと、積極的に製品の改良と開発を進め、同社の増産体制構築に貢献したことを評価されたものです。

## 当社のMIRAFLEX™がトヨタ自動車「新型センチュリー」のボディ鏡面磨きに採用

当社製品のMIRAFLEX™が、トヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ自動車)の最上位モデルに位置付けられる「新型センチュリー」のボディ鏡面磨き用研磨剤として採用されました。

新型センチュリーは独自の「鏡面磨き」を施すことで、ボディ塗装面の平滑性と艶は比類無きレベルに達しています。



今回トヨタ自動車を採用したMIRAFLEX™は、当社が精密研磨で培った技術を活かして独自設計した研磨材であり、トヨタ自動車の匠の技を再現した「緻密なロボット研磨技術による鏡面磨き」の高効率化に貢献しています。

## nano tech 2024に出展



当社は、2024年1月31日(水)～2月2日(金)までの3日間、東京ビッグサイトにて開催されたnano tech 2024に出展しました。

nano techは研究開発の事業化とイノベーション共創を目的に、国内外のナノテクノロジー技術を集めた世界最大級の展示会です。展示ブースでは、白色板状粒子リン酸チタン、超微粒や球状などの特徴を持つ $\alpha$ -SiC粉末、セラミックス溶射材料、積層造形用(3Dプリンター用)超硬合金粉末などを紹介しました。

## 野村IR資産運用フェア2024に出展

当社は、2024年1月10日(水)～1月25日(木)(うちLIVE配信期間は1月10日(水)～1月13日(土)の4日間)、オンライン上で開催された野村IR資産運用フェア2024に出展しました。

オンラインイベントに加えて2023年12月に開催された本フェアの対面型イベント野村IR資産運用フェア2024プレリアルにも参加しました。

会期中は会社の概要や強み、2023年5月発表の中長期経営計画などに関して説明しました。多くの株主・個人投資家の皆様に当社ブースへお越しいただきました。



オンラインブース

## 名証IRエキスポ2024出展のお知らせ

当社は、2024年9月6日(金)、7日(土)に愛知県名古屋市の吹上ホールで開催される名証IRエキスポ2024に出展します。

この機会に当社へのご理解を深めていただけますと幸いです。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

[名証IRエキスポ2024の詳細はこちら](#)

[https://www.nse.or.jp/ir\\_expo/investor/](https://www.nse.or.jp/ir_expo/investor/)

## 石徹白での活動紹介ビデオ6作目を制作

2024年5月に石徹白での活動紹介ビデオ6作目を当社ホームページに掲載しました。

6作目は、当社と石徹白が、互いのことを良く知るための活動である体験交流で、新たに取り組みました稲作の様子をご紹介します。ぜひ、ご覧ください。

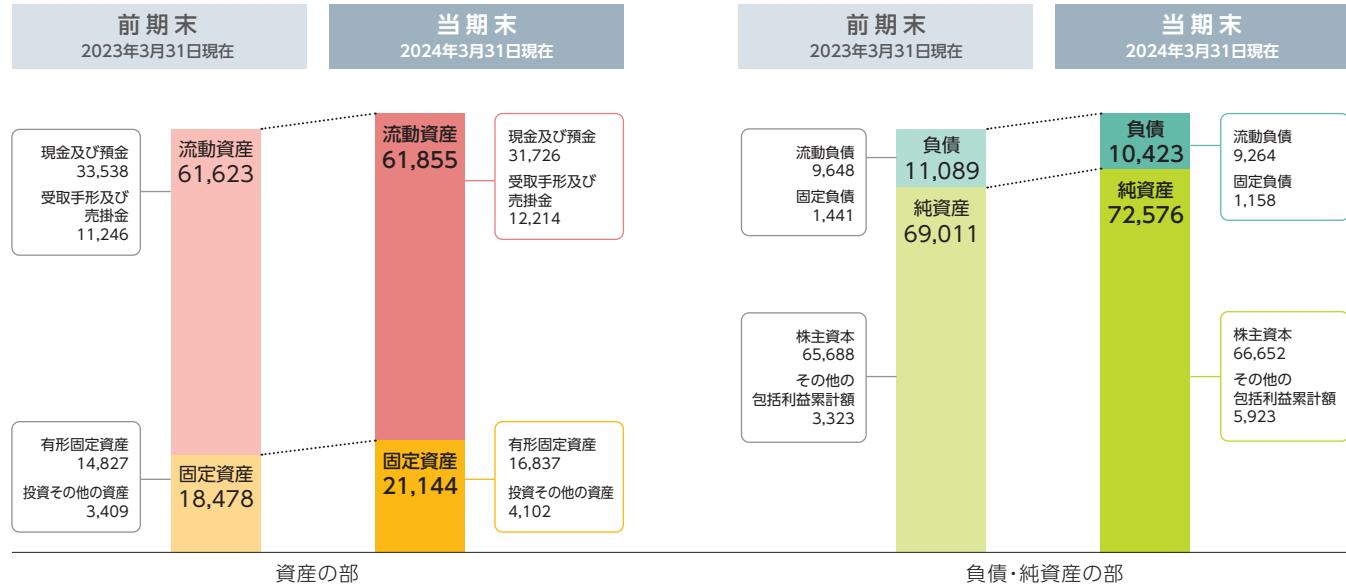


[過去の作品をはじめ、こちらからご覧いただけます。](#)

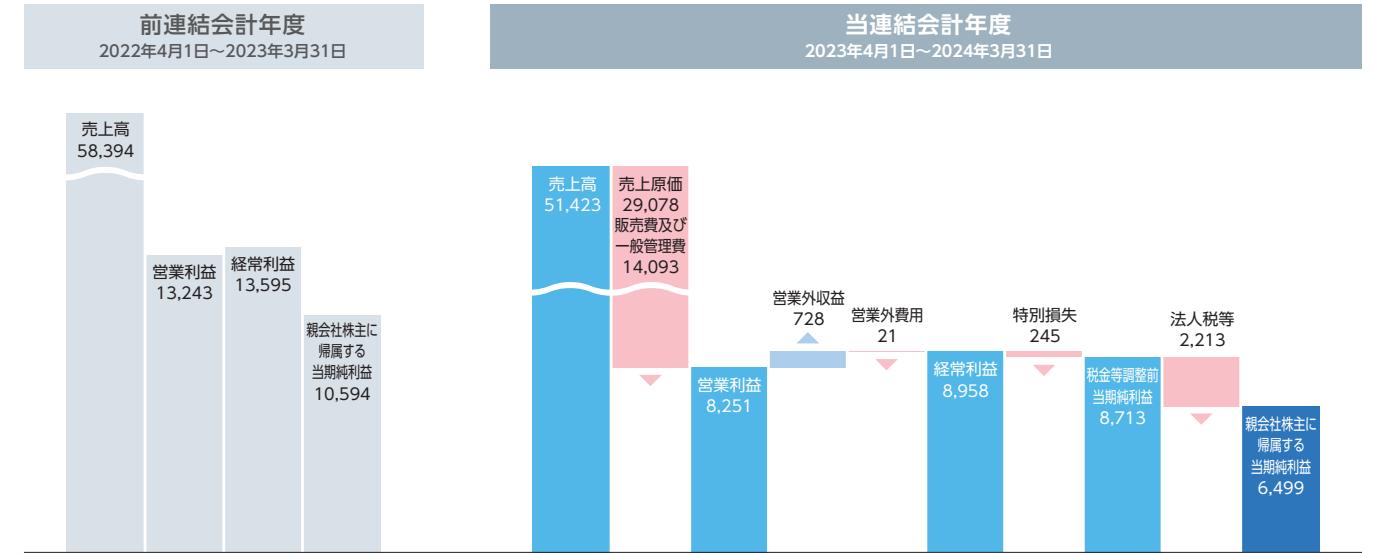
FUJIMI INCORPORATED 広報チャンネル

<https://www.youtube.com/@fujimiincorporated5384>

連結貸借対照表の概要 (百万円)



連結損益計算書の概要 (百万円)



解説

総資産

前連結会計年度末に比べ、2,898百万円増加し、82,999百万円となりました。これは、現金及び預金が1,812百万円減少したものの、土地が1,455百万円、受取手形及び売掛金が967百万円、投資有価証券が950百万円、有形固定資産その他が524百万円それぞれ増加したことなどによるものです。

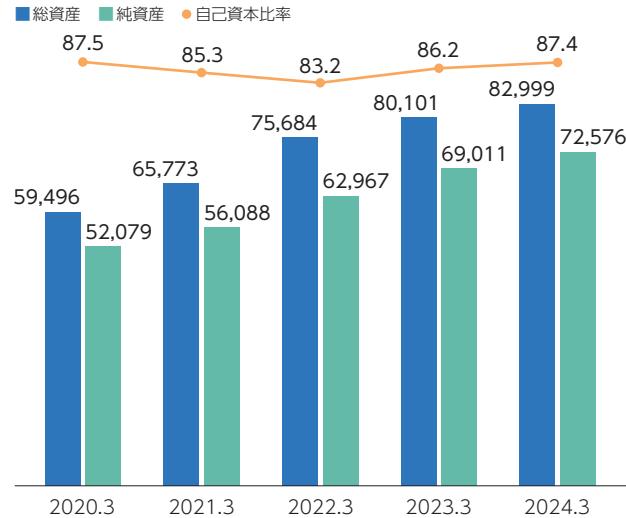
負債

前連結会計年度末に比べ、666百万円減少し、10,423百万円となりました。これは、賞与引当金が247百万円増加したものの、買掛金が932百万円減少したことなどによるものです。

純資産

前連結会計年度末に比べ、3,564百万円増加し、72,576百万円となりました。これは、為替換算調整勘定が1,831百万円、利益剰余金が966百万円増加したことなどによるものです。

総資産・純資産・自己資本比率 (百万円、%)



解説

売上高

半導体デバイスは、AI向け需要が高まる一方、パソコンやスマートフォン向けは市場の低迷に伴い生産及び在庫の調整が継続するなど、各々の用途でバラつきが見られました。シリコンウェハーにおいても稼働調整が継続しており、当社の半導体向け製品の販売が減少したことにより、売上高は前期比11.9%減の51,423百万円となりました。

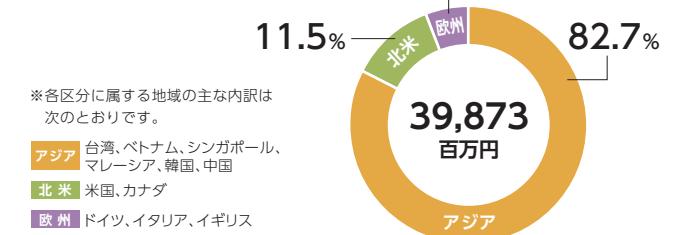
営業利益

前期比37.7%減の8,251百万円となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益

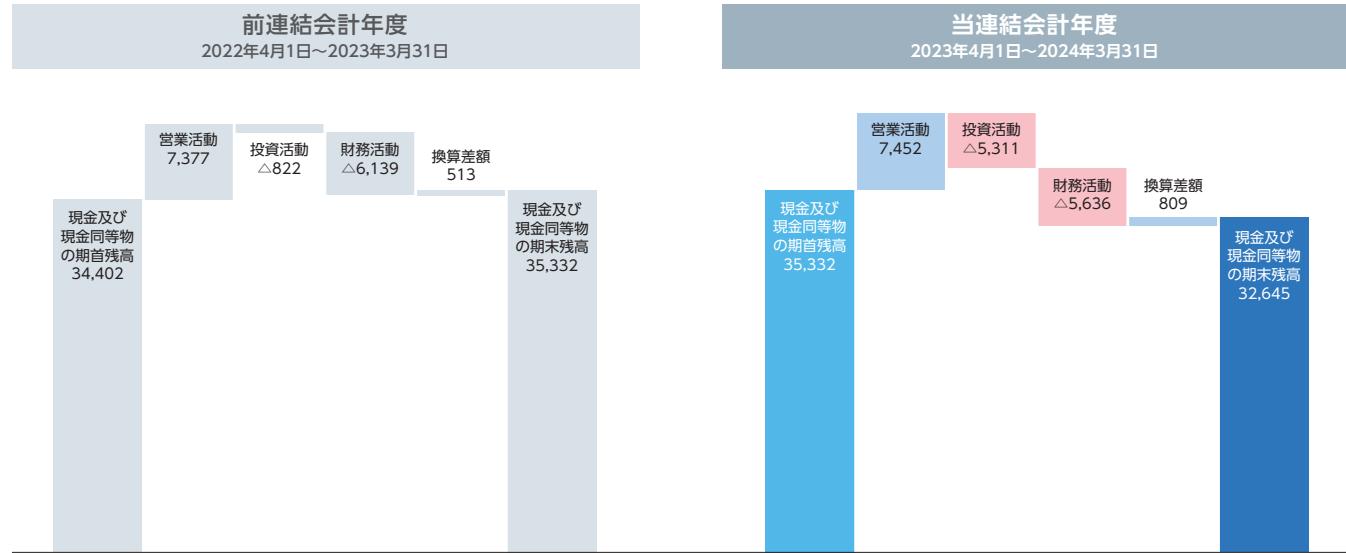
前期比38.6%減の6,499百万円となりました。

海外売上高(仕向先別)

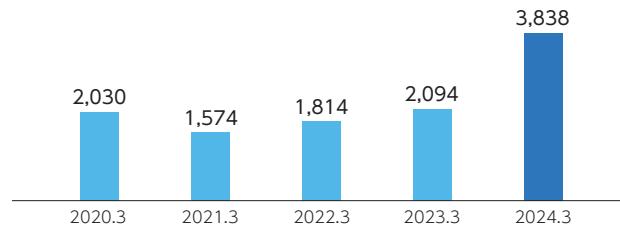


海外売上高	前期末 2023年3月31日	当期末 2024年3月31日
海外売上高 (百万円)	45,249	39,873
連結売上高 (百万円)	58,394	51,423
連結売上高に占める割合 (%)	77.5	77.5

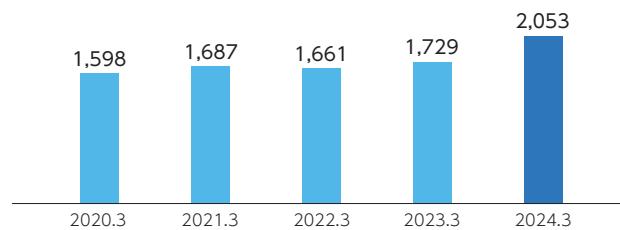
連結キャッシュ・フロー計算書の概要 (百万円)



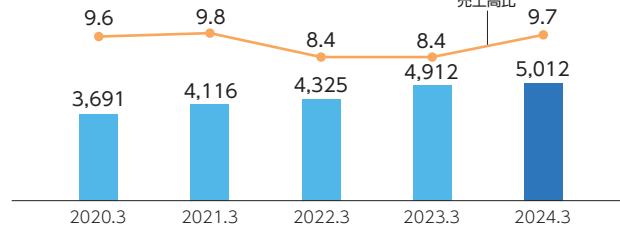
設備投資 (百万円)



減価償却費 (百万円)



研究開発費・売上高比 (百万円、%)



利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、配当につきましては連結配当性向を55%以上とすることを目標として、業績に応じた積極的な株主還元を実施するとともに安定配当の継続にも留意することを基本方針としております。このような方針のもと、当期末配当金につきましては、1株につき36.67円といたします。この結果、中間配当を含めた当期の配当金は1株につき73.34円となります。

株式情報 2024年3月31日現在

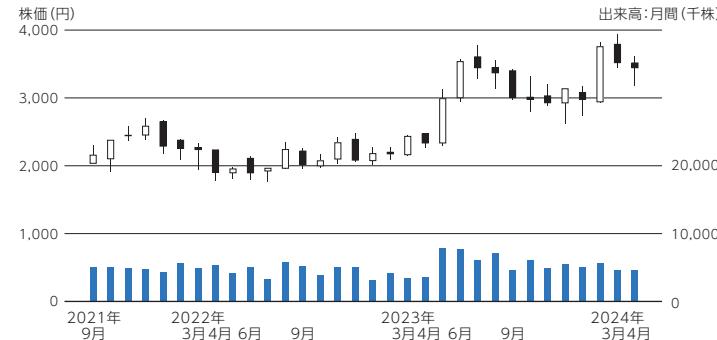
株式の状況

発行可能株式総数	320,000千株
発行済株式の総数	80,098千株
株主数	8,966名

大株主(株主名)	持株数 (千株)*1	持株比率 (%)*2
有限会社コマ	13,381	17.7
日本スタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	7,923	10.5
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	6,159	8.1
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	5,786	7.6
株式会社三菱UFJ銀行	2,185	2.8
日本生命保険相互会社	1,918	2.5
フジミ取引先持株会	1,877	2.4
一般財団法人越山科学技術振興財団	1,800	2.3
第一生命保険株式会社	1,417	1.8
関 敬史	1,323	1.7

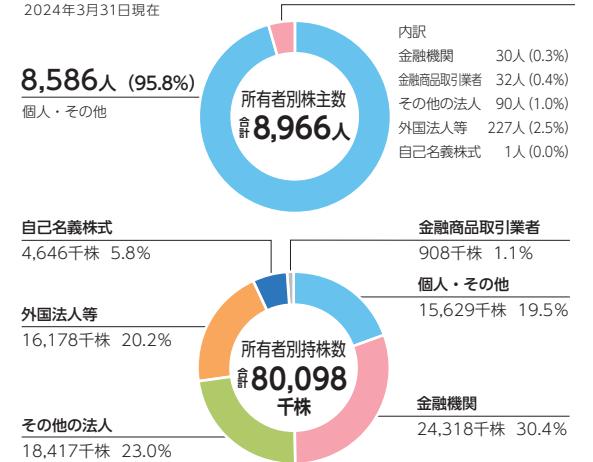
\*1 持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てています。  
\*2 持株比率は、自己株式(4,646,167株)を控除して計算しております。

株価及び出来高の推移



(注) 2023年7月1日を効力発生日として、1株につき3株の割合で株式分割を実施しており、株価は調整後株価を表示しています。

株主分布状況



役員

2024年6月21日現在

代表取締役社長	関 敬史
常務取締役	大脇 寿樹
常務取締役	鈴木 勝弘
取締役	川下 政美*
取締役	浅井 侯序*
取締役	吉村 温子*
取締役	山崎 直子*
常勤監査役	藤川 佳明
監査役	高橋 正彦**
監査役	岡野 勝**

\*印は社外取締役 \*\*印は社外監査役

会社データ 2024年3月31日現在

商号	株式会社フジミインコーポレーテッド
証券コード	5384
本社所在地	愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1 TEL. 052-503-8181(代表)
設立年月日	1953年(昭和28年)3月20日
資本金	4,753百万円
代表者	代表取締役社長 関 敬史
従業員	1,110名(単体791名)